



格物光学1310nm波长的半导体光放大器（SOA）芯片系列专为高增益，高功率，低偏振和宽谱SOA模块而设计，符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产，与国外主流常见产品兼容，并可满足客户快速订制需求，同时交期短、供货快。

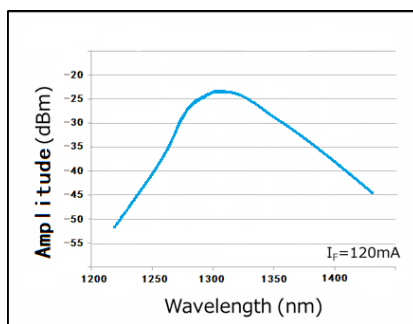
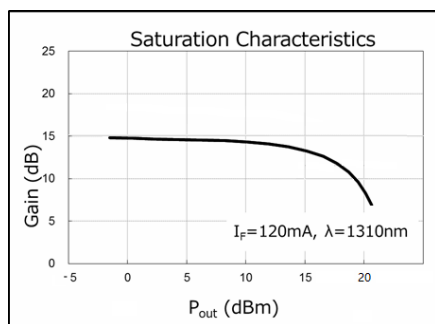
产品特点

- ◆ 芯片COC全工艺国产，自主可控
- ◆ 与主流厂家结构尺寸一致，兼容性强
- ◆ 性价比高，交期短，供货快，需求订制，快速迭代

产品应用

- ◆ 蝶形或小box封装的SOA，用于高速业务信号的光放大
- ◆ 集成在100G光模块的ROSA或TOSA中，提高光功率预算
- ◆ 用于硅光子集成产品，弥补1310nm光信号的传输损耗

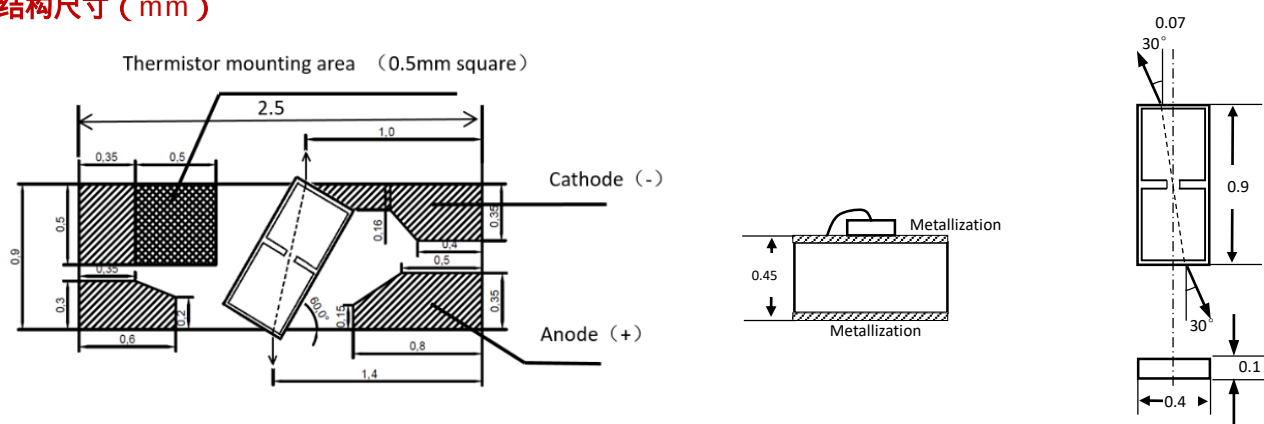
典型特性



产品规格（芯片温度@25℃）

参数	符号	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作波长	λ	---	1260	1300	1340	nm
带宽	$\Delta\lambda$	@-3dB	60	---	---	nm
工作电流	I_f	---	---	120	200	mA
饱和光功率	P_0	$I_f=120\text{mA}$	11	---	---	dBm
小信号增益	G	$I_f=120\text{mA}$ $P_{in}=-25\text{dBm}$	20	22	---	dB
芯片出光角度	---	---	---	30	---	°
噪声系数	NF	---	---	7.5	---	dB
偏振相关增益	PDG	---	---	1.0	2.0	dB
正向电压	V_f	---	---	---	1.8	V
热敏电阻阻值	R_{therm}	$T=25^\circ\text{C}$	9.5	10	10.5	K Ω
热敏电阻电流	I_{therm}	---	---	---	5	mA
光斑尺寸	θ_L/θ_T	---	---	16/30	---	°
工作温度	T_c	$I=I_{\text{op}}$	20	---	45	°C
存储温度	T_{stg}	---	-40	---	85	°C
芯片尺寸(长x宽L x高)	---	---	900x400x100(+/-15)			μm
COC尺寸(长x宽L x高)	---	---	2.5x0.9x0.45			mm

结构尺寸 (mm)



订货信息

订货信息	产品描述	量产阶段
JSA-S3112G20	1310nm-12dBm-20dB-SOACOC	量产